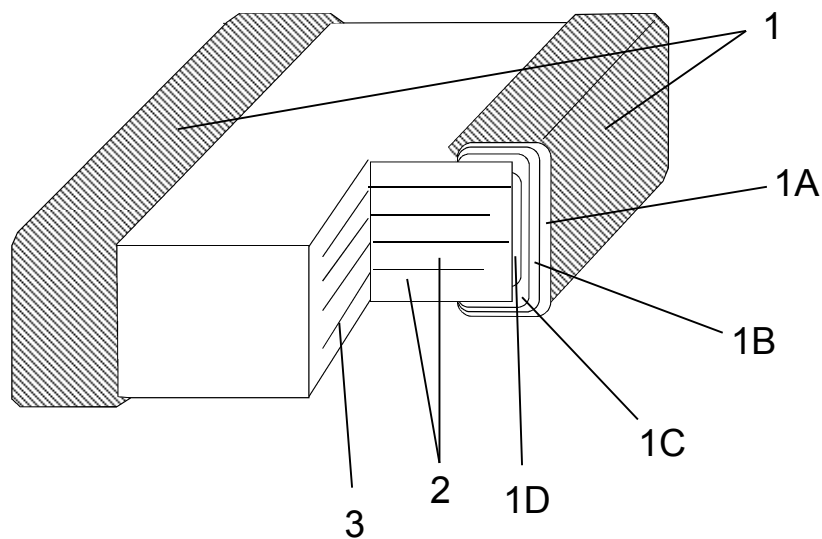


低 ESL 型チップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表

Structure and Material of Low ESL Chip Multilayer Ceramic Capacitor

<LLR Series>



No.	名称(Name)	材料(Material)	
1	外部電極 (Termination)	1A	すずめっき(Sn plated)
		1B	ニッケルめっき(Ni plated)
		1C	銅(Cu)
		1D	酸化インジウムスズ(ITO)
2	誘電体素子(Dielectric layer)	チタン酸バリウム(BaTiO ₃)	
3	内部電極(Inner electrode)	ニッケル(Ni)	